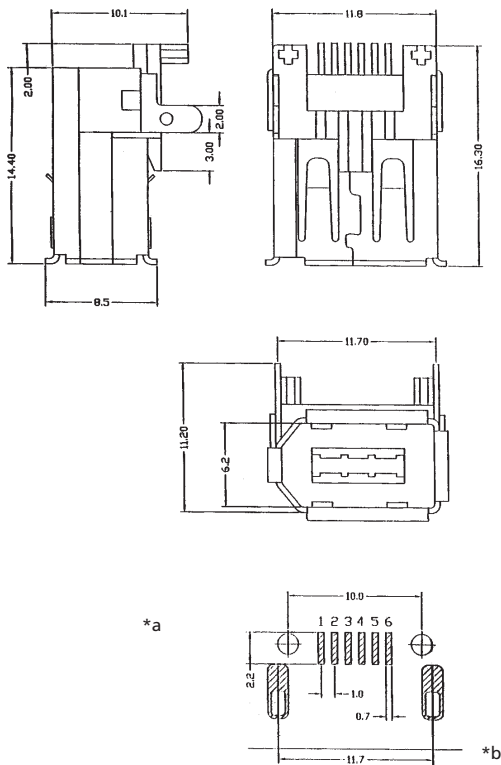




SMT



*a Leiterplattenlayout
printed circuit board layout
modèle de carte imprimée

*b Leiterplattenrand
printed circuit board edge
bord de carte imprimée

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
2417 02	6	100	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

2417 02

IEEE-1394-Einbaukupplung, 6-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

1. Werkstoffe

Gehäuse	CuSn, verzinkt
Kontaktträger	HTN GF
Kontakt	CuSn, selektiv vergoldet

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	IEEE-1394-Steckern 2311, 2316
-------------------	-------------------------------

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 1 A
Bemessungsspannung	30 V AC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

2417 02

IEEE 1394 socket, 6 poles, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

1. Materials

Shell	CuSn, tinned
Body	HTN GF
Contact	CuSn, selectively gold-plated

2. Mechanical data

Mating with	IEEE 1394 plugs, 2311, 2316
-------------	-----------------------------

3. Electrical data

Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	≤ 1 A
Rated voltage	30 V AC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

2417 02

Embase femelle IEEE 1394, 6 pôles, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

1. Matériaux

Boîtier	CuSn, étamé
Corps isolant	HTN GF
Contact	CuSn, doré sélectivement

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteurs mâles IEEE 1394 2311, 2316
-------------------	--

3. Caractéristiques électriques

Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	≤ 1 A
Tension assignée	30 V AC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω